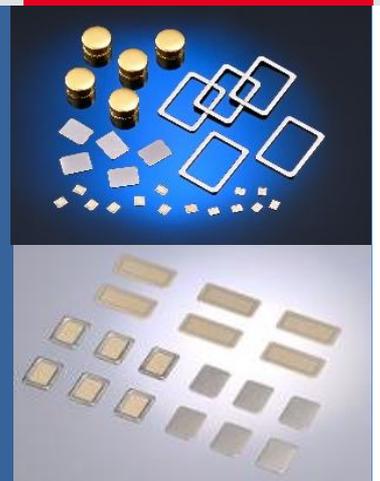


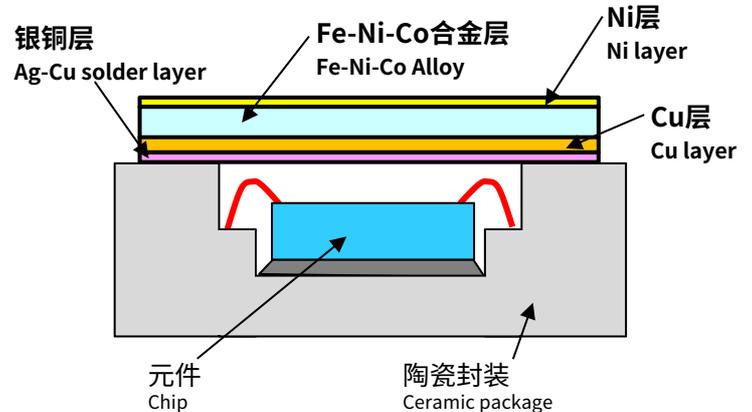
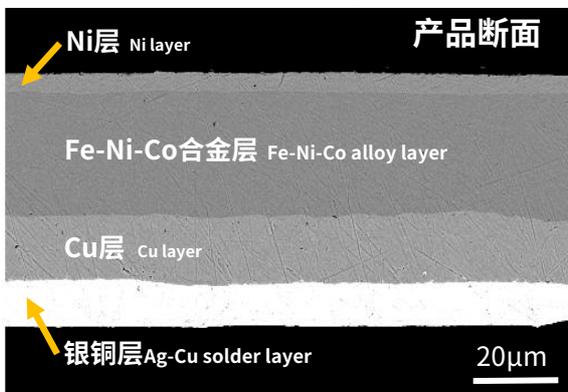
包装密封用Lid制品



作为水晶振子或SAW过滤器等SMD产品的Lid（盖）使用。
 运用本公司的复合技术、电镀技术等，提高了附加价值的产品。
 -通过直接密封在陶瓷封装上可以实现低高度化。
 -与以往产品相比，由于低温密封，所以能够缓和封装的应力。

银铜复合Lid

加工了4层复合材的产品。
 由于将银铜作为钎料预先制成复合材进而可直接焊到陶瓷封装。



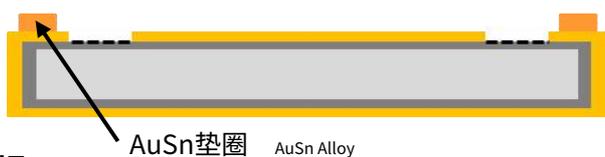
金锡 (AuSn) 焊盖

在KV (Fe-Ni-Co合金) 基材基础上钎焊AuSn的产品。
 通过激光微调技术控制AuSn钎焊区域形状。因此，能够降低AuSn量，
 能够进行稳定密封。

① 激光修边加工



② 钎料设置



③ 钎焊

